证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-014

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		*1

*1：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业 382，信息传输、软件和信息技术服务业 38，批发和零售业 17，电力、热力、燃气及水生产和供应业 10，房地产业 10，建筑业 9，交通运输、仓储和邮政业 8，金融业 7，文化、体育和娱乐业 7，租赁和商务服务业 7，水利、环境和公共设施管理业 6，农、林、牧、渔业 3，科学研究和技术服务业 2，采矿业 2，住宿和餐饮业 1，教育 1，综合 1。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	签署雄帝科技、捷顺科技、2020 年年报；
签字注册会计师	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	签署雄帝科技、捷顺科技、2020 年年报；
	孟娜	2017 年	2012 年	2020 年	2020 年	签署五方光电、博敏电子 2020 年年报
质量控制复核人	赵海荣	1999 年	1998 年	2009 年	2020 年	2020 年度，复核梦网科技、宏达股份 2019 年度审计报告，2019 年度、签署三维股份、麒盛科技、美盛文化、炬华科技、天宇股份、泰林生物等上市公司 2018 年度审计报告；复核梦网科技、易事特 2018 年度审计报告。2018 年度，签署麒盛科技、亚太药业、美盛文化、炬华科技、天宇股份、泰林生物等上市公司 2017 年度审计报告；复核回花顺、章源钨业 2017 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	叶涵	无	无	无	无
2	孟娜	无	无	无	无
3	赵海荣	无	无	无	无

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2020 年度财务审计费用为人民币 50 万元（不含税）。公司 2019 年度财务审计费用为人民币 25 万元（不含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度财务报告审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意提交股东大会审议并授权管理层决定其 2021 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（四）公司监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-017

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）10：00-11：30
- 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，方便投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2020 年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议 。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2021 年 5 月 13 日（星期四）10：00-11：30 在上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.seinfo.com/）以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长黄江先生、总经理张亦锋先生、董事会秘书萃诗涛先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021 年 5 月 5 日（星期三）17 时前通过电子邮件（ivan@leadyo.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在 2021 年 5 月 13 日（星期四）10：00-11：30 在上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.seinfo.com），在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

联系方式：0769-26382738

电子邮箱：ivan@leadyo.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-015

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：被担保人为公司全资子公司：上海利扬创芯片测试有限公司（以下简称“上海利扬”）、东莞利扬芯片测试有限公司（以下简称“东莞利扬”）、东莞市利致软件科技有限公司（以下简称“东莞利致”）。
- 根据日常运营资金需求情况，广东利扬芯片测试股份有限公司（下简称“公司”）及其子公司拟自 2021 年至 2021 年年度股东大会召开之日止，向银行及其他金融机构申请总计不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的综合授信融资额度，并为子公司提供不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的直接融资；为子公司提供总额不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的担保额度，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 66.37 万元，均为对子公司担保。
- 本次担保是否提交股东大会审议：是
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次上市公司及子公司申请对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产的 30%。

一、本次申请综合授信额度并提供融资或担保情况概述

（一）向银行、其他金融机构申请授信及融资

为满足公司 2021 年业务发展需要，公司及子公司 2021 年度向银行、其他金融机构申请的综合授信总额不超过人民币 4 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以公司及子公司与银行、其他金融机构实际发生融资金额为准。综合授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）为子公司提供融资或担保

为保障子公司经营活动中的融资需求，需要公司对子公司提供直接融资或担保，其中公司及子公司 2021 年度给子公司提供直接融资，不超过总额人民币 1 亿元（或等值外币）；公司及子公司 2021 年度给子公司提供融资性担保，不超过总额人民币 4 亿元（或等值外币）。担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

序号	被担保人	担保额度（万元）	公司持股比例
1	上海利扬创芯片测试有限公司	20,000.00	100%
2	东莞利扬芯片测试有限公司	19,000.00	100%
3	东莞市利致软件科技有限公司	1,000.00	100%
合计	—	40,000.00	—

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部全资子公司（含现有、新设立等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司的新增担保额度内调剂使用。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（三）审批程序

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、上海利扬：

公司名称：上海利扬创芯片测试有限公司

住所：上海市嘉定区永盛路 2229 号 3 幢 1 层、2 层

法定代表人：黄江

注册资本：人民币 15,000 万元整

成立日期：2016 年 12 月 06 日

经营范围：从事集成电路测试服务，从事集成电路测试技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额：353,798,982.95 元，负债总额：75,639,816.57 元，净资产：278,159,166.38 元。2020 年实现营业收入 28,295,915.17 元，实现净利润 1,671,421.26 元。

2、东莞利扬：

公司名称：东莞利扬芯片测试有限公司

住所：广东省东莞市东城街道东宝路 119 号 2 栋 2042 室

法定代表人：黄江

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2020 年 7 月 02 日

经营范围：集成电路测试生产、测试、封装、技术开发；探测卡、治具、测试板设计、开发及销售；仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与上市公司的关系：公司全资子公司

东莞利扬成立于 2020 年 7 月 2 日，尚未开展经营，无最近一年及一期财务数据。

3、东莞利致：

公司名称：东莞市利致软件科技有限公司

住所：广东省东莞市南城街道体育路南城段 2 号 1 栋 1 单元 1111 室

法定代表人：黄主

注册资本：人民币叁佰万元整

成立日期：2014 年 12 月 30 日

经营范围：计算机软件、硬件的开发、销售及技术服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额：24,283,356.17 元，负债总额：965,261.12 元，净资产：23,318,095.05 元。2020 年实现营业收入 11,243,362.55 元，实现净利润 8,254,956.76 元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划综合授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或其他金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司全资子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资或担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意公司及子公司申请 2021 年综合授信额度并提供融资或担保事项。

独立董事认为：公司申请的授信额度是充分考虑到公司资金状况和未来经营情况，是为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行并提高经营和决策效率。公司根据授信需要向全资子公司提供担保，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，担保风险可控。公司及子公司申请 2021 年综合授信额度并提供担保事项符合公司实际经营状况，相关的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。我们对本议案表示同意，并同意将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资或担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司及子公司申请 2021 年综合授信额度并提供融资或担保事项。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 66.37 万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 0.06%和 0.07%。截至本公告披露日，公司无逾期担保情形。

八、上网公告附件

1、广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码：688135 公司简称：利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.67 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 136,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,005.88 万元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 96.36%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2020 年利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	利扬芯片	688135	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	萃诗涛	陈伟雄
办公地址	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号
电话	0769-26382738	0769-26382738
电子信箱	ivan@leadyo.com	chenwx@leadyo.com

2 报告期公司主要业务简介

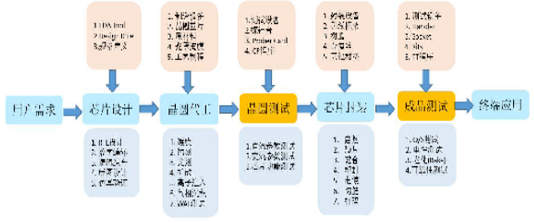
（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内知名的独立第三方集成电路测试技术服务商，主营业务包括集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务（简称“中测”、“Chip Probing”或“CP”）、芯片成品测试服务（简称“成测”、“FinalTest”或“FT”）以及与集成电路测试相关的配套服务。

公司自成立以来，一直专注于集成电路测试领域，并在该领域积累了多项自主的核心技术，已累计研发 39 大类芯片测试解决方案，完成超过 3,500 种芯片型号的量产测试，可适用于不同终端应用场景的测试需求。公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台、3D 高频智能分类机械手等集成电路专用测试设备已运用到公司的生产实践中。公司为国内知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方测试服务，产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域，工艺涵盖 8nm、16nm、28nm 等先进制程。

芯片测试在集成电路产业链中起着必不可少的作用，每颗芯片都需 100%经过测试才能保证其正常使用。通过对芯片产品的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数的专业测试，才能够验证芯片是否符合设计的各项参数指标，确认在晶圆制造和芯片封装的过程中是否存在瑕疵。只有经测试合格的成品芯片才能应用于终端电子产品，真正体现出集成电路测试所扮演的守门员作用。根据芯片的实际应用领域、使用环境差异，以及终端应用对芯片品质的不同要求，公司会针对性的为客户开发不同测试深度、测试强度以及测试覆盖率的定制化 Turnkey 测试解决方案，以响应客户对集成电路测试的个性化性能需求和及时产出的需求。

集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装、芯片成品测试等主要生产环节，其中，晶圆测试和芯片成品测试是公司在集成电路产业链中所处的环节，如下图所示：



公司测试的芯片产品应用于：（1）5G 通讯（RF、PA、FPGA、LNA、Switch 等）；（2）传感器（MEMS、心率监测、生物识别、消防安全等）；（3）智能可穿戴（物联网 IoT、人脸识别、智慧家居等）；（4）汽车电子（车联网、胎压监控、自动驾驶、ETC 等）；（5）计算类芯片（人工智能 AI、服务器、区块链、云计算等）；（6）北斗应用（雷达、导航、定位等）；（7）工业类和消费类产品（医疗电子、电表应用、智能手机等）；（8）信息安全（金融 IC 卡、加密算法、U-KEY 等）。

（二）主要经营模式

1. 研发模式

集成电路测试研发是基于不同类型和应用领域芯片的特点，选用最优测试平台基础上，研究芯片功能模块组成及特点，通过硬件开发和软件开发，分别设计不同模块的测试方法，搭建实验验证软硬件环境，完成测试技术的验证、确认和定型。公司的研发项目主要是根据市场驱动来进行立项，通过每年对市场需求的汇总提炼，前瞻性的开展项目研发，主要包含三个阶段：需求评估阶段、方案研发阶段及方案验收阶段。

2、采购模式

公司的采购均严格按照《采购管制程序》、《供应商管理办法》等公司规章制度执行，设有采购计划、采购实施及仓库管理三个业务模块，分别负责采购计划接收和供应商管控、对外具体实施采购和到货入库出库管理工作。公司的采购分为测试设备和测试辅料的采购。公司的测试设备主要为进口设备，测试设备的采购一部分是根据生产计划的需要按需采购，一部分是公司根据集成电路行业的发展趋势进行预见性的采购。测试辅料的采购主要按照每个具体的测试项目采取按需采购的模式采购。

3、生产模式

公司主营业务是独立第三方晶圆测试和芯片成品测试，公司主要采用以销定产的生产模式，实行订单式生产。公司在与客户签订订单后，根据订单情况进行个性化的测试方案设计及量产测试，以应对客户的差异化需求。公司建立了多维度的生产管理制度和考核机制，以测试良率、交付及时率和设备稼动率作为核心考核指标，并根据达成情况不断调整、优化生产过程，确保公司测试服务质量的持续提升。

4、销售模式

公司采用直销模式，销售部门是营销中心，营销中心的主要职责是根据公司的发展战略制定销售策略，收集各类市场信息，根据公司的经营目标制定具体的营销方案并实施对外业务洽谈与市场开拓等。营销中心设销售总监、销售经理、业务助理和客服专员。销售经理和业务助理负责新老客户的开发、组织项目实施、客户维护等；客服专员主要负责合同文件管理、跟踪项目实施、客户回款管理、收集和汇总客户意见等。

5、盈利模式

公司作为国内知名的独立第三方集成电路测试服务商，凭借自主开发的芯片测试技术、高端的芯片测试设备以及无尘化的芯片洁净测试环境，向芯片设计公司提供测试方案开发、晶圆测试、芯片成品测试等服务，从中取得收入、获得盈利。公司所从事的集成电路测试属于技术含量高、人才密集、资金密集的高科技现代服务业，公司的发展符合集成电路行业的特点和发展趋势。公司将不断地提升运营管理能力和生产效率，降低生产成本，提升自身技术水平和服务能力，增加市场份额，以期在未来获得更多的收入和利润。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“C 制造业”门类下的“C3973 集成电路制造”；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“C 制造业”门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1.新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.4 集成电路制造”。

集成电路测试行业的技术演进随着终端应用领域的变革、晶圆和封装工艺的发展而不断进步，国内集成电路测试产业经历了以下三个发展阶段：

①90 年代前后，国内的无线电、半导体厂主要生产分立器件，产品型号相对单一。随着国内电子产品市场化的起步，玩具和钟表类等消费类应用以软封装（COB）为主，对品质要求不高，国内芯片测试资源相对匮乏，效率低下。一般通过对比测试方法目搭测试板进行单颗芯片测试为主，为产品做配套服务，只做 Open/Short 的好坏判断，成品芯片测试的需求很少，当时的测试产业尚不具有商业价值。

②2000 年后，随着无锡上华、华虹 NEC、中芯国际等晶圆制造工厂建成投产，受台湾地区代工模式深化的影响，芯片设计公司逐渐兴起，产品方向以智能卡、家电、数码及电脑周边应用为主。当时市场软封装和硬封装等形式共存，同时对晶圆测试和芯片成品测试的需求增加。应市场变化和客户需求，出现细分的专业测试行业，同时市场上还包括以下几种测试模式的存在：封测一体公司、晶圆代工企业配套的测试产能、IDM 厂商、芯片设计公司配套的测试产能等。测试平台开始步入自动化测试（以 5-10MHz/＜128Pin）的 ATE 为主。测试产业分散，专业度有待提升，缺乏地域优势，有必要形成规模化集群效应，从而具备商业价值。

③近十年来，随着移动终端和工业智能的蓬勃发展，智能手机及其周边应用开始大规模普及，日趋复杂的医疗、工控、汽车电子、物联网及安全领域的 SoC 芯片成为主流，终端电子产品对芯片品质和测试专业度要求越来越严苛，专业的独立第三方芯片测试服务成为诸多知名芯片设计公司的共同选择。测试技术的迭代需要不断的资本和人才投入，对交期以及成本优势提出更高要求。

根据 WSTS 统计，2020 年全球半导体市场销售额 4,390 亿美元，同比增长了 6.5%。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。根据海关统计，2020 年中国进口集成电路 5,435 亿块，同比增长 22.1%；进口金额 3,500.4 亿美元，同比增长 14.6%。2020 年中国集成电路出口 2,598 亿块，同比增长 18.8%，出口金额 1,166 亿美元，同比增长 14.8%。

为加快推进我国集成电路产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。2020 年 8 月，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（下称“8 号文”），制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。

集成电路专业代工模式的出现造就了产业链的专业分工，专业测试在集成电路产业链中起着成本控制和保证品质的关键作用。多 PIN 同测数是测试技术能力的标志，对 ATE 测试设备和测试方案开发能力都提出更高要求，集成电路测试行业兼具资本投入大，人才和技术壁垒高的特点。

集成电路测试行业的技术演进随着终端应用领域的变革、晶圆和封装工艺的发展而不断进步。集成电路独立第三方测试有别于其他可采用标准化的验证、抽测抽检企业，测试是芯片质量最后的保障，每颗芯片都必须经过 100%测试才能交付终端电子产品的使用。随着芯片的日趋复杂，对芯片的测试已不仅仅是判断能不能用为标准的简单测试，对测试人才提出跨学科、深厚的知识储备的综合要求，尤其要具备电子电路、通信与信号系统、机械原理、软件开发等专业知识，测试需聚焦于芯片电子电路、性能、逻辑功能、信号、通信、系统应用等技术。确认芯片逻辑功能、管脚功能、读写功能等是否正确，并最终判断芯片功能和性能在不同工作条件下是否达到设计规范的要求。

随着集成电路行业在国内的快速发展，迫使专业测试加快发展，率先实现产能扩张、建立技术优势的厂商先发优势明显，有望通过规模和技术壁垒迅速拉开与竞争者的差距，迎来良好的发展契机。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路作为信息产业的基础与核心，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是电子信息产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。集成电路行业的推动作用强，倍增效应大，在推动经济发展上发挥着重要作用。

公司经过多年的发展，已发展成为国内最大的独立第三方集成电路测试基地之一。自创立之初，公司就定位于建立 12 英寸晶圆级测试能力，同时向下兼容 8 英寸晶圆级测试。公司较早地实现了多项高端芯片的测试量产，已累计研发 39 大类芯片测试解决方案，完成超过 3,500 种芯片型号的量产测试，可适用于不同终端应用场景的测试需求。

公司的主要核心技术来源于自主研发，相关技术在生产应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中。公司的技术先进性主要体现在两方面：一方面为针对不同的芯片，自主开发和设计集成电路测试方案的能力；另一方面为公司通过对测试设备进行定制改进，以适应测试方案，并完成大规模批量测试，解决测试准确性和效率成本问题。公司对集成电路测试领域核心技术的发展持续关注和跟踪并深入研究开发，通过不断加大技术研究和产品开发投入力度，对公司的技术不断进行改进和创新，公司的技术水平得到了很大的提高和改善。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年以来，集成电路行业的发展又体现出一些新的特征，这些新特征的出现，对细分的集成电路测试行业而言，是发展的良机。

①专业化分工趋势越来越明显，传统的 IDM 模式压力日益加大

全球集成电路相关企业主要分为两类，第一类是涵盖了集成电路设计、制造以及封装、测试为一体的垂直整合型公司，也被称作为 IDM 公司，例如英特尔、索尼、海力士、美光等，其经营模式都是垂直整合型为主，即在公司内部完成芯片设计、制造、封装、测试的每一环节，业务流程包括半导体制造的整个过程。在 IDM 模式下公司需要投入大量的资金建立生产工厂和购买设备，承担芯片制造的全过程，同时还要持续投入巨额研发资金追赶先进工艺，风险高、资产重。集成电路行业的第二类模式是 Fabless 模式，即芯片设计公司仅从事芯片设计工作，然后将芯片制造、封装、测试等工作全部委托于第三方代工的模式，例如华为海思、美国超威半导体（AMD）、汇顶科技、豪威科技等，Fabless 模式起源于台积电。

上个世纪八十年代末，台积电成立，专注于芯片制造即晶圆制造环节，专业化的分工铸就了台积电的行业领导地位。近期，传统的 IDM 图像传感器公司索尼，也历史性的首次将图像传感器交给了台积电代工，再次证明了集成电路行业的专业化分工趋势的优势在强化，而传统的 IDM 模式的压力日益增大。

随着消费电子的快速发展，新兴技术更迭迅速、更加追求市场领先的特点，传统的 IDM 模式在跟上先进工艺的道路上越走越难，集成电路行业这一专业化、分工化的趋势意味着会有越来越多的晶圆制造和集成电路测试订单从传统的 IDM 产商流出，对公司专注集成电路测试细分领域的经营模式构成持续的利好。

②集成电路 Chipless 商业模式的兴起

所谓 Chipless 模式，就是以苹果、华为这类拥有巨大终端产品市场的品牌公司，成立专门的芯片设计团队进行自主芯片的设计和研发，同时掌握前端的芯片设计和后端应用两大关键环节，并将中间的芯片制造、封装、测试环节委托专业化的代工厂完成的商业模式。

在中国大陆市场，Chipless 模式的兴起表现得极为明显。以格力、阿里、小米、美的为代表的，掌握着巨大终端产品或终端应用的企业纷纷进入芯片设计行业，大力投入适用于自家产品的专业芯片及目有系统级芯片（SoC）的研发和设计，以图减少对传统 IDM 模式企业的依赖，使得 IDM 模式占据的市场份额将进一步减少，而专业分工模式市场份额将增大，进而使得独立第三方测试企业的市场份额将进一步扩大，有利于公司的发展。

③中国大陆晶圆厂加大投资力度，产能快速扩张

受益于集成电路产业加速向中国大陆转移的趋势，中国大陆作为全球最大的集成电路终端产品消费市场，国际产能不断向中国大陆转移，包括中芯国际、华虹宏力、武汉新鑫、三星、台积电、海力士等中资、外资集成电路企业纷纷在中国投资建设晶圆制造厂。晶